



2023年3月6日

各 位

会 社 名 太 洋 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 細 江 美 則
(コード番号：6663 東証スタンダード)

問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 経 営 管 理 部 長 園 部 直 孝
電 話 0 7 3 - 4 3 1 - 6 3 1 1

電子基板事業における設備投資に関するお知らせ

当社は、主力事業である電子基板事業における高密度配線基板及び高周波基板の新たな生産体制の構築について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、当社といたしましては、本件が今後の業容拡大に貢献するものと期待しておりますが、今回の設備投資等は計画に織り込んでおり、2023年12月期の業績予想に変更はありません。本件に関し開示すべき事項が生じた場合には、適切に開示してまいります。

(別紙)

「電子基板事業における高密度配線基板及び高周波基板の生産体制構築に関するお知らせ」

以 上

2023年3月6日

各位

会社名 太洋工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 細江美則
問合せ先

取締役執行役員 清原 旭
製造本部長

電話 073-431-6311

電子基板事業における高密度配線基板及び高周波基板の生産体制構築 に関するお知らせ

当社は、主力事業である電子基板事業において、下記のとおり高密度配線基板及び高周波基板の生産体制構築に向けた生産設備の新規導入をお知らせいたします。

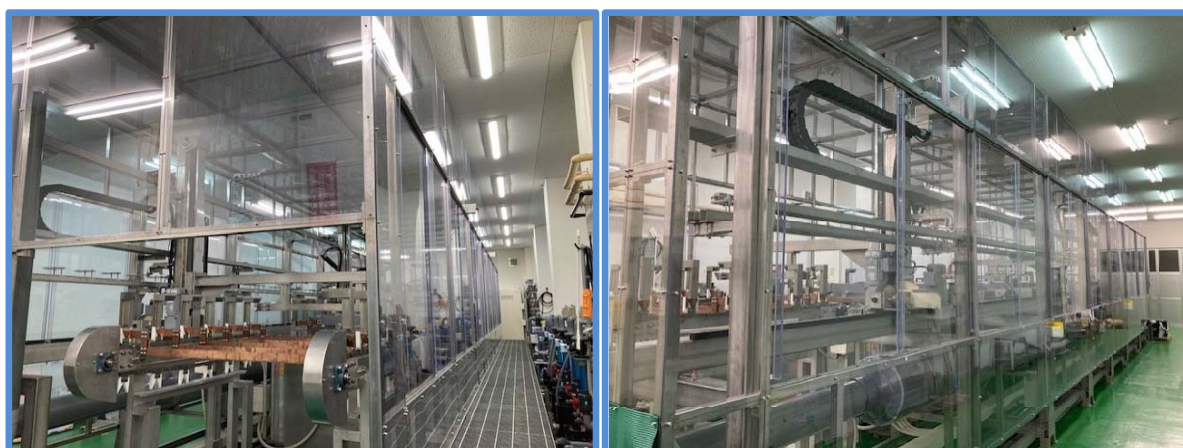
記

1. 生産体制構築の背景

医療・通信・車載分野において使用される機器については、さらなる高機能・小型軽量化・通信速度の高速化等の流れから、高密度配線に対する要求が高まっております。また、高速通信分野では5G、Beyond 5G/6G等、伝送損失や高周波特性の要求を満足させるために高周波基板が必要となります。これらの高密度配線基板及び高周波基板は、一般的な電子基板とは製造工程・工法が異なります。この点が特に重要なファクターであり、「銅めっき厚の管理」、「パターンの現像/エッチング・パターン露光」について精度向上が必須となります。

当社はこれまで実験装置を用いて、高密度配線基板及び高周波基板の開発を行ってまいりましたが、このたび技術の確立と高まる製品化ニーズに対応するため、高密度配線基板及び高周波基板の生産設備導入を決定いたしました。今後、高難度FPCの安定供給をもって、医療・通信・車載分野へのシェア拡大を実現してまいります。

設備の内容	稼働開始予定	投資総額
高精度全自動銅めっきライン	2023年6月	約230百万円
微細パターン現像/エッチングライン	2023年8月	
高密度・高精細パターン露光装置	2024年4月	



高精度全自動銅めっきライン（設備外観の様子）



高精度全自動銅めっきライン（基材自動搬送の様子）

2. 今後の見通し

従来設備では、銅めっき厚を高精度に管理することが当社の大きな課題となっておりましたが、高精度全自動銅めっきラインを導入することで、銅めっき厚のばらつき（現状±56.7%→±20%）を高精度に管理することができ、高精細な配線が可能となります。また、インピーダンス（※）のばらつき（現状±10%→±5%）を改善するとともに、高周波特性の向上、多層基板の薄銅化が可能となります。

また、高精細パターンの形成においても、従来設備では $15\mu\text{m}/15\mu\text{m}$ （ライン/スペース）が限界であったものの、微細パターン現像/エッチングライン及び高密度・高精細パターン露光装置を導入することで、 $12\mu\text{m}/12\mu\text{m}$ （ライン/スペース）の高精細な配線を形成することが可能となり、これらの技術を開発・確立することで、高密度配線基板及び高周波基板の安定供給と、省力化・省人化を踏まえた自動ラインの構築による量産対応を見込んでおります。

中長期的に設備投資を計画・検討する上で、2020年7月28日付け「（開示事項の変更）本社工場の建替え延期に関するお知らせ」においてお知らせ・延期している工場エリアの増床も視野に入れ、国内外の顧客ニーズに応じてまいります。

なお、今回の設備投資の一部は、新分野展開や事業再構築等の取り組みによる補助金等を活用いたします。

※ インピーダンスとは、交流における電流の流れにくさを表すもので、単位は Ω （オーム）で表されます。

以 上